

Mini-Din-Buchsen, gerade/gewinkelt, geschirmt/ungeschirmt Mini-Din Jacks, Straight/Right-Angled, Shielded/Unshielded

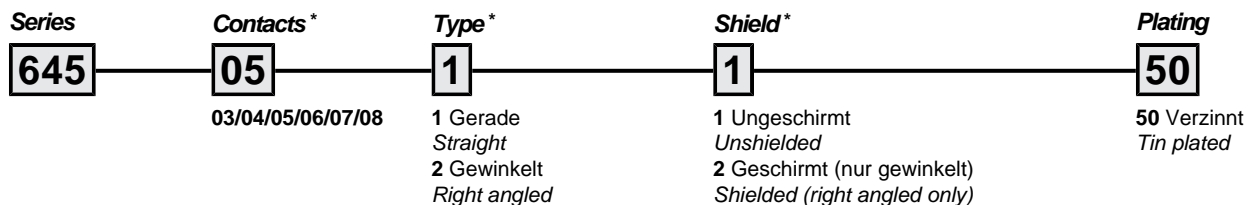
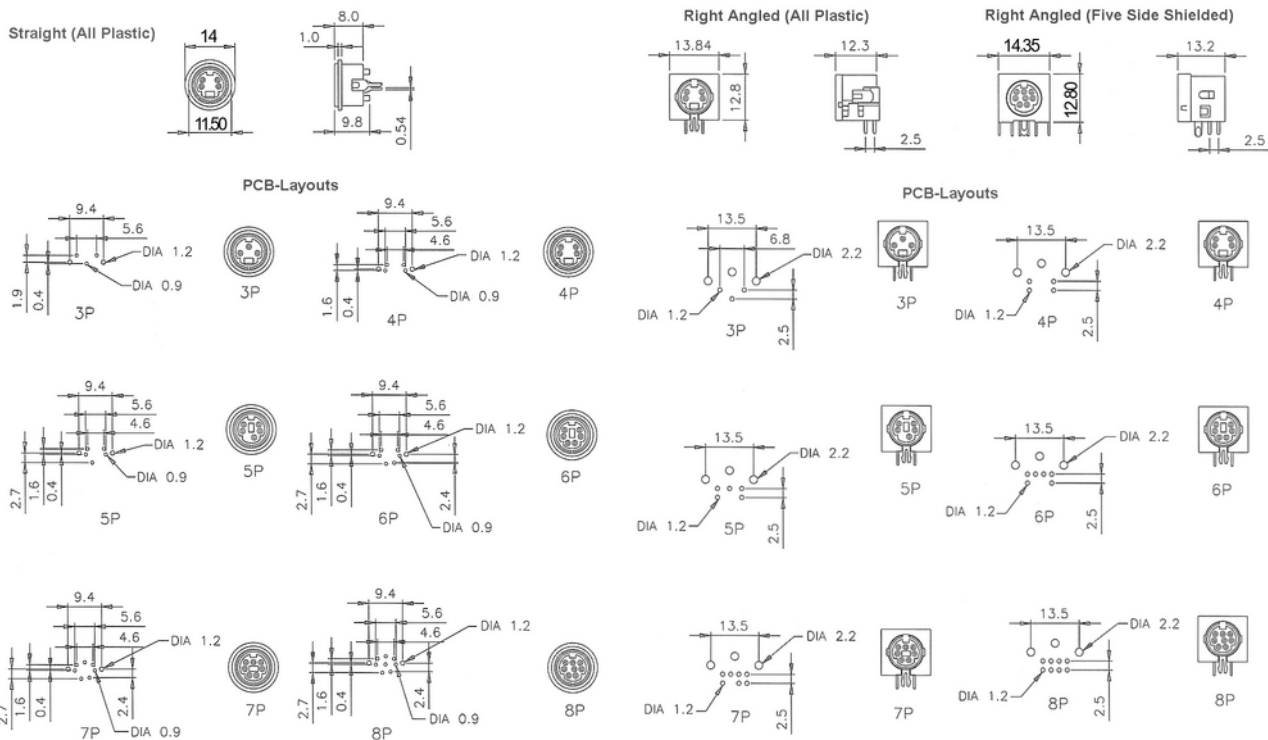
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 15mΩ <i>< 15mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>> 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{DC} <i>500V_{DC}</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A <i>1A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +105°C <i>-55°C ... +105°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellenlötverfahren <i>Wave soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker Serie:
Mate with Connector Series:
646 (Male)



Andere Veredelungen auf Anfrage.
More plating options on request.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* *This is an order example - please replace by your specifications.*

Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

